

LDT シリーズ
SERIES

リード線形 105°C 標準品
105°C Standard, Lead Wire Type

- ・超小形化品。
Ultra Miniaturized.
- ・大容量品。
High Capacitance.
- ・外装に難燃性(UL94 V-0)のエポキシ樹脂使用。
Coated with flame-retardant (UL94 V-0) epoxy resin.



◆規格表 / SPECIFICATIONS

項目 Items	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-55~+105°C
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10~35Vdc
静電容量範囲 Capacitance Range	4.7~47μF (475~476) E6シリーズ 4.7~47μF (475~476) E6 series
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (M)
損失角の正接 (tan δ) Dissipation Factor	1.5%以下 (1kHz±20%, 5Vrms以下) 1.5% or less (1kHz±20%, 5Vrms or less)
耐電圧 Voltage Proof	定格電圧の150%を1分間印加後、異常のないこと。 Nothing abnormal shall be found, when applying 150% of the rated voltage for 1 minute.
絶縁抵抗 Insulation Resistance	300MΩ・μF以上 (定格電圧印加1分後) 300MΩ・μF or more (After 1 minute application of rated voltage)

◆呼称方法 / PART NUMBER

□□□ 定格電圧 Rated Voltage	LDT シリーズ名 Series	□□□ 静電容量 Capacitance	□ 静電容量許容差 Capacitance Tolerance	□□□ 副記号 Option	□□ リード加工記号 Lead Forming		
↓		↓	↓		↓		
記号 Code	定格電圧 Rated Voltage	記号 Code	静電容量 Capacitance	記号 Code	許容差 Tolerance	記号 Symbol	加工形状 Lead Style
10	10Vdc	475	4.7μF	M	±20%	TV	テーピングつづら折り Taping Ammo Pack
16	16Vdc	106	10μF			(下表参照) (See below table)	リードカット / Lead Cut
25	25Vdc	226	22μF				
35	35Vdc						

◆寸法図 / DIMENSIONS

(mm)

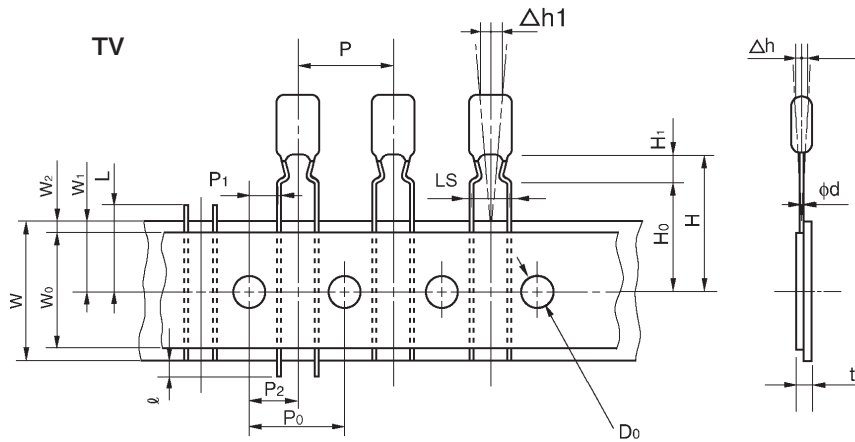
リードカット形状 / Lead cut style

L	リード加工記号 / Code
3.5	B1
4.0	B3
4.5	B5
5.0	B7

◆標準品一覧表 / STANDARD SIZE **リード加工記号 / Lead Forming

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size (mm)						品番 Part No.
		A	B	C	F±1.5	LS±0.5	φd±0.05	
10	47	8.5	5.2	14.6	6.0	5.0	0.6	10LDT476M**
16	33	8.5	5.2	14.6	6.0	5.0	0.6	16LDT336M**
25	15	8.6	5.2	11.1	6.0	5.0	0.6	25LDT156M**
	22	8.5	5.2	14.6	6.0	5.0	0.6	25LDT226M**
35	4.7	8.7	5.2	8.6	6.0	5.0	0.6	35LDT475M**
	6.8	8.6	5.2	11.1	6.0	5.0	0.6	35LDT685M**
	10	8.5	5.2	14.6	6.0	5.0	0.6	35LDT106M**

◆テーピング仕様 / TAPING SPECIFICATIONS



項目 Items	寸法(mm) Size
P	12.7±1
P0	12.7±0.2
P1	3.85±0.5
P2	6.35±0.5
LS	5.0+0.8/-0.2
W	18.0+1.0/-0.5
W0	5.0 min
W1	9.0±0.5
W2	3.0max
φd	0.6±0.05
H	20.0±0.75
H0	16.0±0.5
H1	5.0max
D0	4.0±0.2
L	11.0max
ℓ	0max
Δh	0±0.1
Δh1	0±0.1
t	φd±0.9max

◆基板実装条件 / SOLDERING CONDITIONS

<プリヒート/Preheating>

温度/Temperature	≦120°C
時間/Time	≦90sec

- フローの繰り返し回数は2回までとし、2回目のフローはコンデンサ温度が常温に戻ってから行ってください。
Flow soldering cycle is limited to two(2).
The second soldering should be done after the capacitor itself has returned to room temperature.

<フロー実装/Flow soldering>

